

## 基板・モジュールレベルの静電気対策セミナー（関西地区開催）

期日： 2025年3月7日（金）（13:00～17:00）

会場： プリーゼプラザ（JR 大阪駅桜橋口徒歩 5 分） 8 階：803 号室

主催： 一般財団法人日本電子部品信頼性センター

半導体デバイスは、組立工程の取扱いによる静電気障害、電子システム構成後での静電気ノイズ障害に対し、オンチップ保護回路、基板上保護回路及びシステム筐体設計対策が取られ、コンポーネント ESD 試験標準、工程静電気管理標準、システムレベル ESD Immunity 試験標準が制定されてきた。しかしながら、中間製造品となる基板・モジュールレベル対象の CBE（Charge Board Event）、HMM（Human Metal Model）等の分析、耐性設計、工程管理標準等は近年の半導体デバイスの進歩、電子システム性能向上に対し遅れている感がある。そこで、RCJにおいて、基板・モジュールレベルでの静電気対策委員会が6年前に発足、現在まで日進月歩の技術進展に対応した分析、報告活動を行っている。今回のセミナーは、これら委員会活動内容と IEC 61000-4-2 ESD Immunity 試験標準検討委員の検討内容を説明、紹介する。

### 基板・モジュールレベルの静電気対策セミナープログラム

2025年3月7日（金）			
順番	時間	テーマ	講師
0	(13:00～13:05)	本セミナーの主旨説明	福田 保裕 (RCJ基板・モジュール静電気対策委員会 委員長)
1	(13:05～14:00)	基板・モジュールレベルの静電気障害及び保護対策概要（電子部品からシステムまでの静電気障害の基礎的説明も含む）	福田 保裕 (RCJ委員長)
2	(14:00～14:45)	基板レベルCBE障害事例、対策実例説明	板垣 達也 ((株)東芝 生産技術センター)
3	(14:45～15:00)	休憩	
4	(15:00～16:00)	IEC61000 4-2 を中心とした System ESD Immunity試験分析	石田 武志 ((株)ノイズ研究所)
5	(16:00～16:45)	CBE、HMM試験分析によるESD・SEED保護設計対策	徳永 英晃 (パナソニック インダストリー(株))
6	(16:45～17:00)	Q&A:基板/モジュールレベルESD対策	講師全員

注) 一部プログラムが変更される場合があります。

## ＜参加要領＞

区分	テキスト	定員	参加費（消費税込み）（円）	
			RCJ賛助企業会員 ESDC	非会員
① 基板・モジュールレベルの静電気対策セミナー	参加申込者には、発表ppt資料のダウンロードサイトを連絡しますので、そこから資料をダウンロードして下さい。印刷物の配布はありませんので、ご了承下さい。	30名	11,000	14,300
オプション				
② RCJ成果報告書 ( <a href="#">R-2022-M-01</a> )	R-2022-M-01 「2022 年度 基板・モジュール静電気対策検討委員会調査報告書」 <セミナー参考資料>		5,500	

<注： 報告書の目次は、上記報告書番号をクリックするとご覧になることができます。>

申込先：（一財）日本電子部品信頼性センター

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-6 カミナガビル3F

E-mail: shiono@rcj.or.jp、TEL : 03-5830-7601、FAX : 03-5830-7602、

申込締切： 2025年2月28日（金）

申込方法： ホームページのフォーム <https://rcj.or.jp/ESDseminar-application>よりお申し込み下さい。

参加申込者には、請求書と参加券等をお送りします。また、後日、セミナー資料ダウンロードサイトをメールで連絡します。オプションの成果報告書購入者には、資料ダウンロードサイトをメールで連絡します。

振込銀行 三菱UFJ銀行、日本橋中央支店、普通預金口座 0084373

口座名： 名義：（一財）日本電子部品信頼性センター

注）請求書には振り込み希望日を記載しますが、実際の振込は、貴社の都合に合わせて頂いて結構です。

### ◇ 会場案内

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー 7-8階

<https://www.breeze-plaza.com/>



### ＜問い合わせ先＞

（一財）日本電子部品信頼性センター（RCJ）基板・モジュール静電気対策委員会事務局（塩野、佐藤）

TEL : 03-5830-7601 FAX : 03-5830-7602 E-Mail : shiono@rcj.or.jp